

AFE2256 256 チャネル、デジタル X 線フラットパネル検出器用アナログ フロントエンド

1 特長

- 256 チャネル
- オンチップ、16 ビット ADC
- フォトダイオード短絡への耐性
- 高性能:
 - ノイズ: 750 電子 RMS
(1.2pC 入力電荷範囲)
 - 低い相互関連ノイズ
 - 積分非直線性
内部 16 ビット ADC で ± 2 LSB
 - スキヤン時間: $< 20\mu\text{s} \sim 204.8\mu\text{s}$
- 積算:
 - 6 つの選択可能でフルスケール入力: 0.6pC (最小値) ~ 9.6pC (最大値)
 - 内部タイミング ジェネレータ (TG)
 - 内蔵の相互関連付けダブル サンプラー
 - パイプライン化された積算と読み取りによるスループット向上 - 積算中にデータを読み取り
 - シリアル LVDS 出力
- 単純な電源方式:
 - AVDD1 = 1.85V
 - AVDD2 = 3.3V
- 低い消費電力
- ナップおよび完全パワー ダウン モード
- カスタム COF (Chip-On-Film) パッケージ

2 アプリケーション

- フラット パネル、X 線検出器
- 電荷検出器
- 容量測定

3 概要

AFE2256 は、フラットパネル検出器 (FPD) ベースのデジタル X 線システムの要件を満たすように設計された 256 チャネルのアナログ フロントエンド (AFE) です。このデバイスには 256 の積分器、デュアル バンキング搭載フルスケール充電レベル選択用のプログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、相関ダブル サンプラー、256:4 のアナログ マルチプレクサが搭載されています。

また、このデバイスには 4 つの 16 ビット逐次比較型 (SAR) アナログ/デジタル コンバータ (ADC) も内蔵されています。ADC からのシリアル データは、低電圧差動信号 (LVDS) 形式で利用可能です。

ナップおよびパワー ダウン モードにより大幅な電力削減が可能であり、バッテリ動作のシステムでは特に有用です。

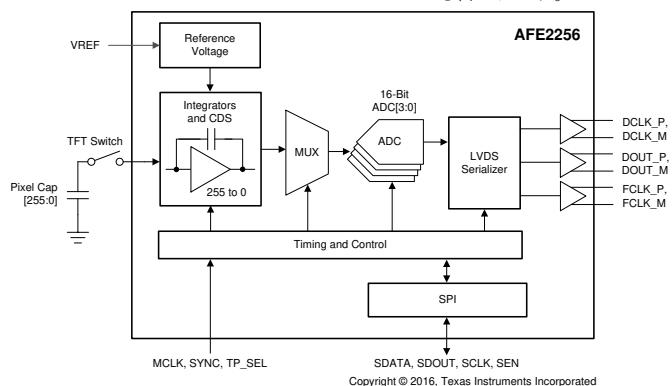
完全なデータシートや、その他の設計資料のご請求には、[AFE2256 を請求してください](#)

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ ⁽²⁾
AFE2256	TDU (COF, 320)	38.00mm×28.00mm
	TDR (COF, 325)	48.35 mm × 21.5 mm
	TBN (COF, 325)	48.35 mm × 21.5 mm

(1) 供給されているすべてのパッケージについては、[セクション 6](#) を参照してください。

(2) パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はビンも含まれます。



AFE2256 のブロック図

⚠️ このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

English Data Sheet: [SBAS693](#)

Table of Contents

1 特長.....	1	4.2 Trademarks.....	3
2 アプリケーション.....	1	4.3 静電気放電に関する注意事項.....	3
3 概要.....	1	4.4 用語集.....	3
4 Device and Documentation Support.....	3	5 Revision History.....	3
4.1 Documentation Support.....	3	6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information....	3

4 Device and Documentation Support

4.1 Documentation Support

4.1.1 Related Documentation

For related documentation, see the following:

Texas Instruments, [TPS7A8300 2- \$\mu\$ A, 6- \$\mu\$ VRMS, RF, LDO Voltage Regulator data sheet](#)

4.2 Trademarks

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

4.3 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことをお勧めします。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

4.4 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

5 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

	Page
Changes from Revision B (May 2016) to Revision C (December 2023)	Page
• ドキュメント全体にわたって AFE2256TBN パッケージ仕様を追加	1
• 表紙ページの回路図を変更して明確化.....	1
Changes from Revision A (July 2015) to Revision B (May 2016)	Page
• 「完全なデータシートのご請求」リンクを追加.....	1
Changes from Revision * (March 2015) to Revision A (July 2015)	Page
• 量産用にリリース.....	1

6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
AFE2256TBN	Active	Production	COF (TBN) 325	32 JEDEC TRAY (5+1)	Yes	AU	N/A for Pkg Type	0 to 70	AFE2256TBN
AFE2256TBN.A	Active	Production	COF (TBN) 325	32 JEDEC TRAY (5+1)	Yes	AU	N/A for Pkg Type	0 to 70	AFE2256TBN
AFE2256TDR	Active	Production	COF (TDR) 325	32 JEDEC TRAY (5+1)	Yes	AU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 85	AFE2256TDR
AFE2256TDR.A	Active	Production	COF (TDR) 325	32 JEDEC TRAY (5+1)	Yes	AU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 85	AFE2256TDR
AFE2256TDU	Active	Production	COF (TDU) 320	35 EIAJ TRAY (10+1)	Yes	AU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 85	AFE2256TDU
AFE2256TDU.A	Active	Production	COF (TDU) 320	35 EIAJ TRAY (10+1)	Yes	AU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 85	AFE2256TDU

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative

and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月